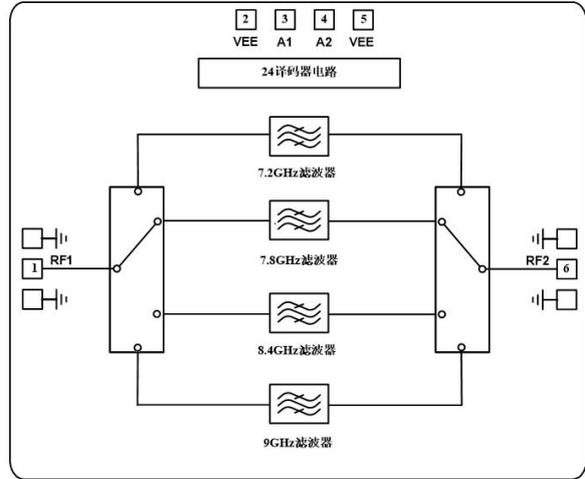




### 主要特点

- 内部集成 2: 4 译码器
- 通道数目: 4
- 通带频率: 7.2 GHz  
7.8 GHz  
8.4 GHz  
9 GHz
- 功耗: -5 V @ 6 mA
- 输入 P-1: 26 dBm
- 芯片尺寸: 3.5 × 5 × 0.1 mm<sup>3</sup>

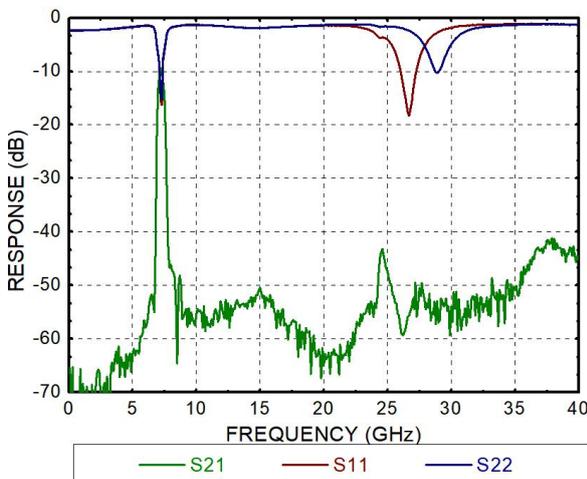
### 功能框图



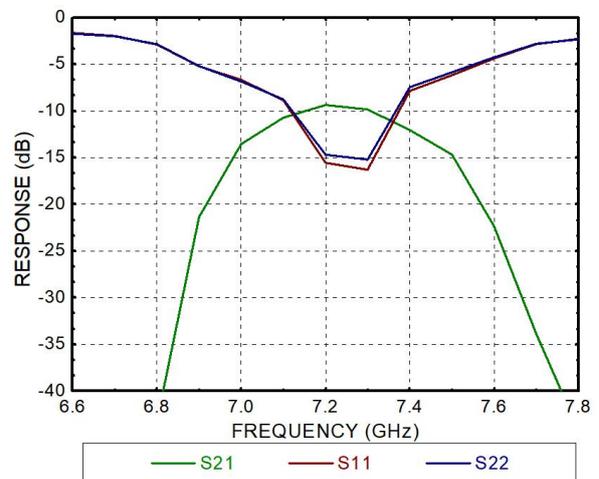
### 性能指标 ( $T_A = +25^\circ\text{C}$ , $VEE = -5\text{V}$ )

参数	7.2GHz	7.8GHz	8.4GHz	9GHz	单位
插入损耗	9	9	10	10.5	dB
回波损耗	12	12	12	12	dB
带外抑制	50@6.6GHz 45@7.8GHz	45@7.2GHz 45@8.4GHz	45@7.8GHz 45@9GHz	45@8.4GHz 45@9.6GHz	dB

### 7.2GHz反射系数

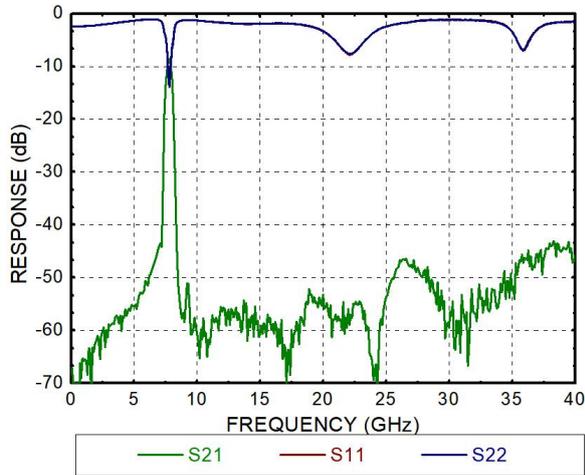


### 7.2GHz反射系数

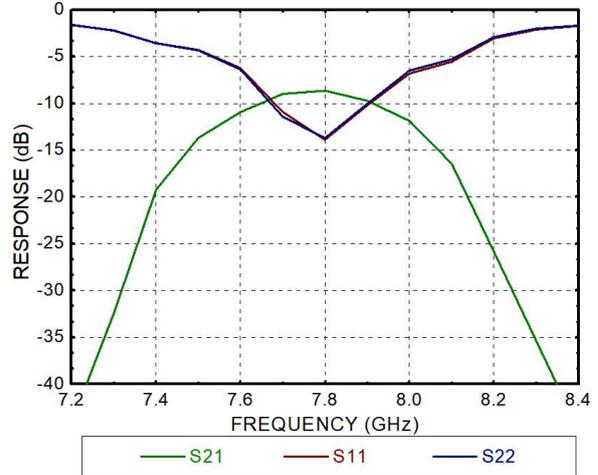




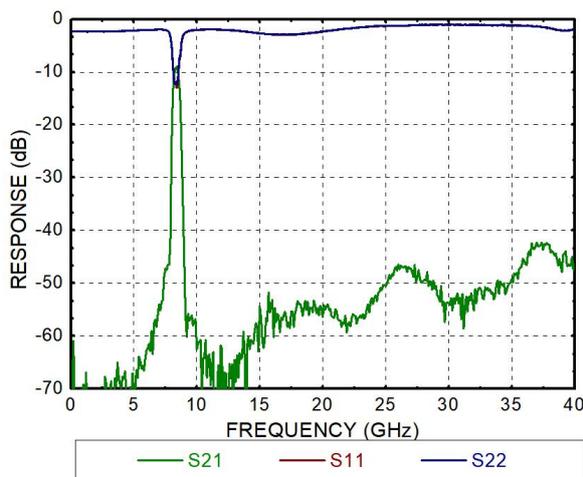
### 7. 8GHz反射系数



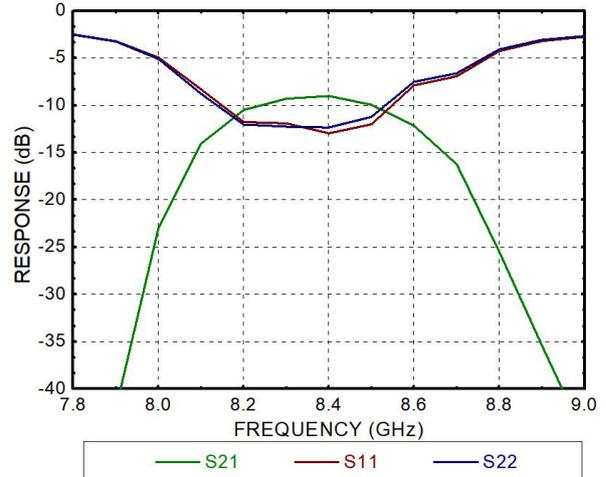
### 7. 8GHz反射系数



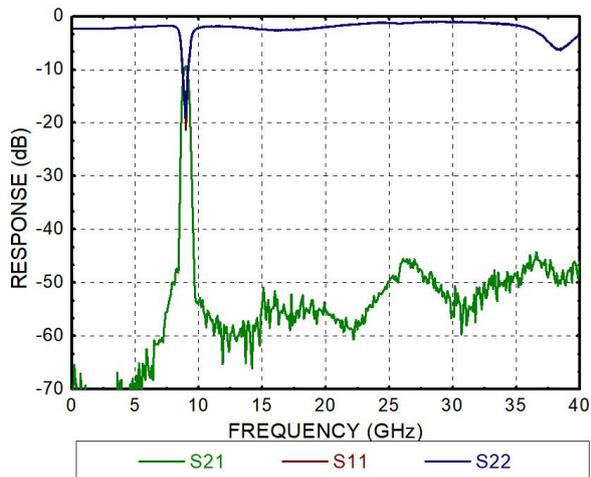
### 8. 4GHz反射系数



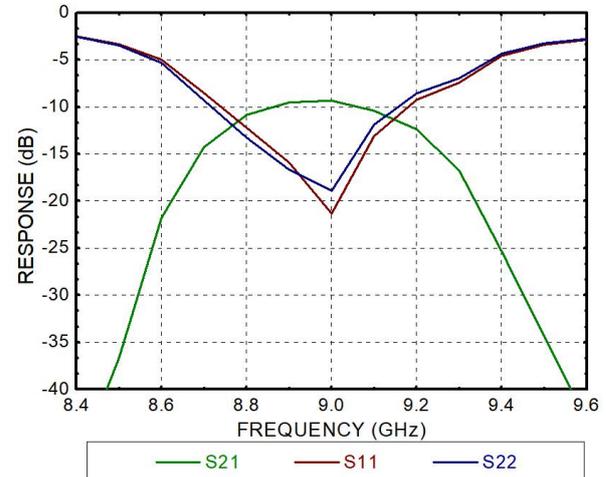
### 8. 4GHz反射系数



### 9GHz反射系数

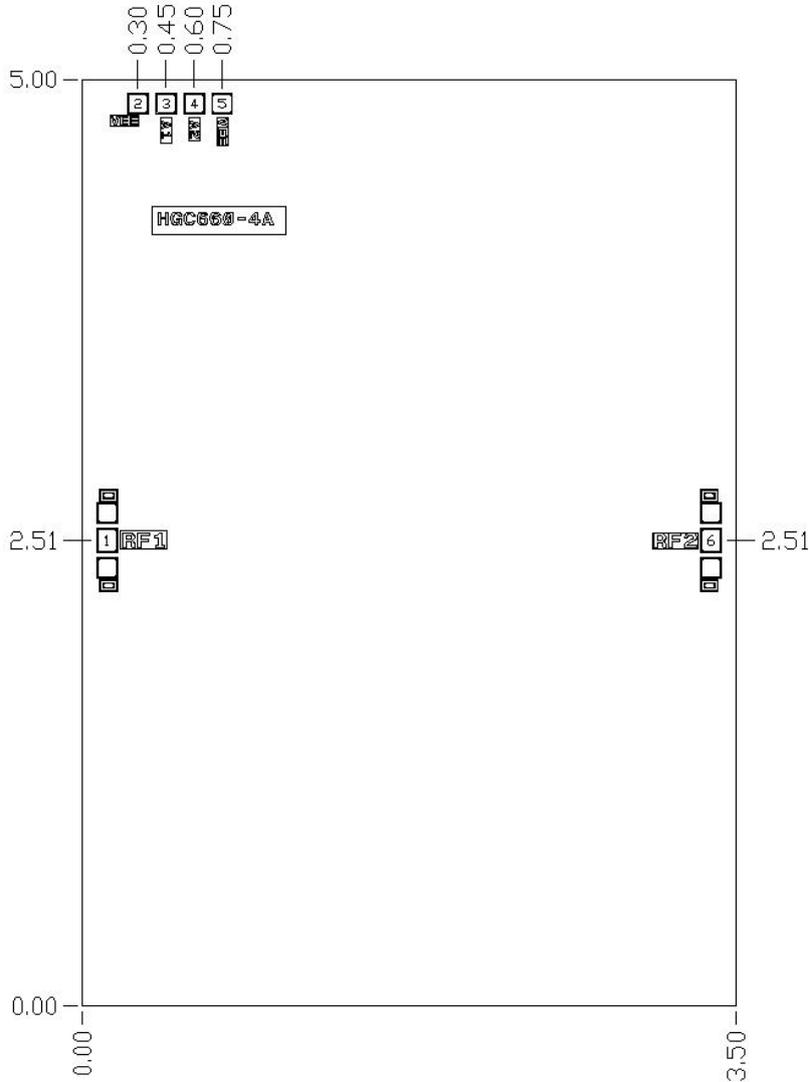


### 9GHz反射系数





## 物理参数



## 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是 RF 信号输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
6	RF2	该焊盘是 RF 信号输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2, 5	VEE	该焊盘是驱动电路电源端口, 使用时任选一端接-5V 电压
3-4	A1-A2	该系列焊盘是控制端口, 控制关系见真值表
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

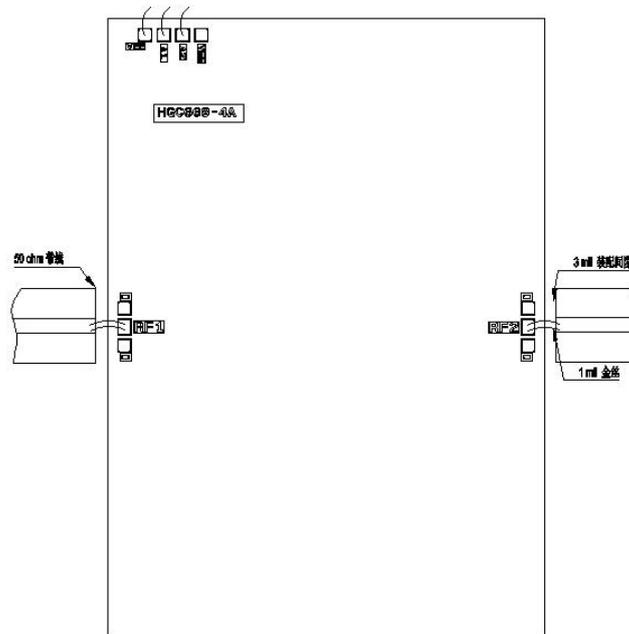


### 真值表

通道	A1	A2
7.2GHz	0	0
7.8GHz	0	1
8.4GHz	1	0
9GHz	1	1

“0”电平范围：0~0.2V，“1”电平范围：2.3~5V

### 推荐装配图



### 注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 厚度为 100  $\mu\text{m}$
3. 典型键合焊盘尺寸为 120\*100  $\mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN；厚度：0.6 $\mu\text{m}$ ，

### 极限参数

1. 电源电压：-6 V
2. 射频输入功率：+30 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$